

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

注:本次股东大会还将听取程毅、杨辉、曹智三位独立董事所作的2023年度述职报告。 1、网络投票时间:2024年4月20日(星期一)上午9:30至下午15:00。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows share categories and registration dates.

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

6. 通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料原件及复印件。 (一) 本次会议出席者食宿及交通费自理。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票, 反对, 弃权. Lists resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票, 反对, 弃权. Lists resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

委托书签(盖章): 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托日期: 年月日。 附件2: 采用累积投票制选举董事、监事和监事的投票方式说明。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票, 反对, 弃权. Lists resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

注:本次股东大会还将听取程毅、杨辉、曹智三位独立董事所作的2023年度述职报告。 1、网络投票时间:2024年4月20日(星期一)上午9:30至下午15:00。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows share categories and registration dates.

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

6. 通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料原件及复印件。 (一) 本次会议出席者食宿及交通费自理。

本次业绩预告会议召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易唐App查看本次业绩预告说明会的召开情况及主要内容。

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

Table with columns: 证券种类, 上市交易所简称, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists securities and company information.

2 本报告期公司主要业务简介 (一) 主要经营模式 1 盈利模式 公司属于集成电路行业,主要业务为提供封装测试服务。

Table with columns: 上游封装, 中间封装, 后封装, 封装测试, 封装材料. Lists various stages and materials in the packaging process.

(二) 主要经营模式 1 盈利模式 公司属于集成电路行业,主要业务为提供封装测试服务。



2 采购模式 公司的采购模式为按单采购,由物料采购部统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单,根据需求单向供应商下达采购订单。

3 生产模式 公司采用直接模式进行销售,制定了相应的销售管理制度。 4 销售模式 公司属于集成电路行业,主要业务为提供封装测试服务。

5 研发模式 公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动,夯实已有技术基础,同时进一步拓展技术边界,并持续投入研发资源。

(三) 项目研发 公司的研发项目主要来源于以下渠道:一是研发中心定期调研行业发展趋势,结合公司发展战略,进行前瞻性布局。

(四) 质量控制 公司在项目研发过程中,建立了完善的质量管理体系,确保研发项目的质量和进度。 6. 通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料原件及复印件。

亚细亚等亚洲新兴市场区域,中国台湾地区是最早兴起集成电路封装测试代工模式的地域,也是目前全球最大的集成电路封装基地,中国大陆位居其次。

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

Table with columns: 证券种类, 上市交易所简称, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists securities and company information.

2 本报告期公司主要业务简介 (一) 主要经营模式 1 盈利模式 公司属于集成电路行业,主要业务为提供封装测试服务。

Table with columns: 上游封装, 中间封装, 后封装, 封装测试, 封装材料. Lists various stages and materials in the packaging process.

(二) 主要经营模式 1 盈利模式 公司属于集成电路行业,主要业务为提供封装测试服务。



2 采购模式 公司的采购模式为按单采购,由物料采购部统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单,根据需求单向供应商下达采购订单。

3 生产模式 公司采用直接模式进行销售,制定了相应的销售管理制度。 4 销售模式 公司属于集成电路行业,主要业务为提供封装测试服务。

5 研发模式 公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动,夯实已有技术基础,同时进一步拓展技术边界,并持续投入研发资源。

(三) 项目研发 公司的研发项目主要来源于以下渠道:一是研发中心定期调研行业发展趋势,结合公司发展战略,进行前瞻性布局。

(四) 质量控制 公司在项目研发过程中,建立了完善的质量管理体系,确保研发项目的质量和进度。 6. 通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证明材料原件及复印件。